

产品、研发、测试

基于Framework的固件卷结构的分析

陈楣¹, 周振柳², 许榕生^{1, 2}

- 1.福州大学 数学与计算机科学学院, 福州 350002
- 2.中国科学院 高能物理研究所 计算中心, 北京 100049

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-5-9 接受日期

摘要 对固件卷的结构进行了系统的分析, 详细阐述了多个文件数据进行层层封装有机构成一个整体的情况, 并分析了此结构的特点。最后通过实验验证了分析的正确性。

关键词 [BIOS](#) [EFI](#) [UEFI](#) [架构](#) [固件卷](#)

分类号

Analysis of firmware volume format based on framework

CHEN Mei¹, ZHOU Zhen-liu², XU Rong-sheng^{1, 2}

- 1.College of Mathematics and Computer Science, Fuzhou University, Fuzhou 350002, China
- 2.Computing Center, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract

The analysis of firmware volume format based on the framework is presented. We expound how one or more files constitute a whole firmware volume through hiberarchy encapsulation and analyse the features of encapsulation. Finally, the correctness of the analysis is validated through trial.

Key words [BIOS](#) [EFI](#) [UEFI](#) [framework](#) [firmware volume](#)

DOI:

通讯作者 陈楣

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(714KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“BIOS”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [陈楣](#)
- [周振柳](#)
- [许榕生](#)
-